

复合导热垫片

UTP100-H10-9是使用硅胶与导热陶瓷填料，以玻璃纤维布为补强材料，经特殊工艺加工而成。具单面自粘型，防刺穿，抗击电压增强，是一款非常柔软，具有优异的可压缩性的导热硅胶垫片，可与电子元器件紧密接触，有效降低界面热阻，导热性能表现极佳。在-40°C~150°C可以稳定工作，同时满足UL94 V-0等级阻燃要求。



特性和优点

- 导热系数1.2~1.3W/(m·K)
- 超柔软、高压缩可至50%
- 单面自粘
- 玻纤布增强材料强度，可冲孔不变形
- 高电气绝缘

典型应用

- LED照明设备
- 功率转换设备
- 平面显示器
- 冷却器件到底盘或框架之间
- 高电气绝缘要求的MOS管

典型属性			
属性	典型值	测试方法	
颜色	棕红色+白色	目视	
厚度 (mm)	0.5~12.0	ASTM D374	
密度 (g/cc)	2.0	ASTM D792	
硬度 (Shore 00)	10	ASTM D2240 @6mm	
拉伸强度 (MPa)	2.5	ASTM D412	
延伸率 (%)	60	ASTM D412	
渗油率	(Φ/mm)	≤40	滤纸吸附@压缩25%,125°C,48h 初始直径Φ30mm
	(%)	<0.5	
耐温范围 (°C)	-40~150	/	
防火性能	V-0	UL 94	
保质期 (月)	12	温度<40°C避免挤压、暴晒	
电性能			
击穿电压 (kV)	≥7.5	ASTM D149 @0.5mm	
介电常数	5.3	ASTM D150 @1000Hz	
体积电阻率 (Ω·cm)	≥10 ¹³	ASTM D257	
导热性能			
导热系数 (W/(m·K))	1.2~1.3	ISO 22007-2	
热阻 (°C·in ² /W)	≤1.2	ASTM D5470 @50psi,0.5mm	